



柔性电子基板上薄膜材料可靠性原位评价系统

文献类型：专利

作者 张广平, 朱晓飞 and 张滨

发表日期 2009-08-05

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本实用新型涉及一种柔性电子基板上薄膜材料可靠性原位评价系统。该原位评价系统的基座内侧相对设置有平动滑块、固定块,固定块与基座固定连接,平动滑块与基座呈滑动连接,简支梁可动端安装于平动滑块上,简支梁固定端安装于与平动滑块相对的固定块上,与平动滑块相连的简支梁可动端和与固定块相连的简支梁固定端相对应,简支梁可动端和简支梁固定端之间安装试样,试样的一端放置在与基座相连的简支梁固定端,试样的另一端置于简支梁可动端。本实用新型无需考虑薄膜材料的导电性,对非导电薄膜材料仍然适用。实验操作简单快捷,可对样品进行原位实时定位观测与分析,解决...

公开日期 2009-08-05

语种 中文

专利申请号 CN201285359

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66311]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 张广平, 朱晓飞 and 张滨. 柔性电子基板上薄膜材料可靠性原位评价系统. 2009-08-05.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：金属研究所

浏览	下载	收藏
121	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

